

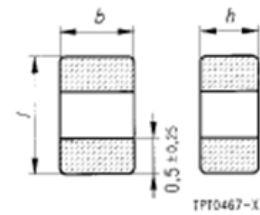
80 V, 120 °X

应用

- q 过电流保护
- q 延时
- q 电流稳定

特点

- q 热敏电阻芯片银端接
- q 小型
- q 短的响应时间
- q 适用于回流焊接，
也为导电粘合
- q 适用于自动贴装
- q 可在磁带
(标准配置模式)



终止

外形尺寸 (mm)

公差 (I, B, H ± 0,2 mm)

TYPE	I	b	h	SIZE
A 1607	3,2	2,5	1,7	1210
A 1707	3,2	2,5	1,7	1210

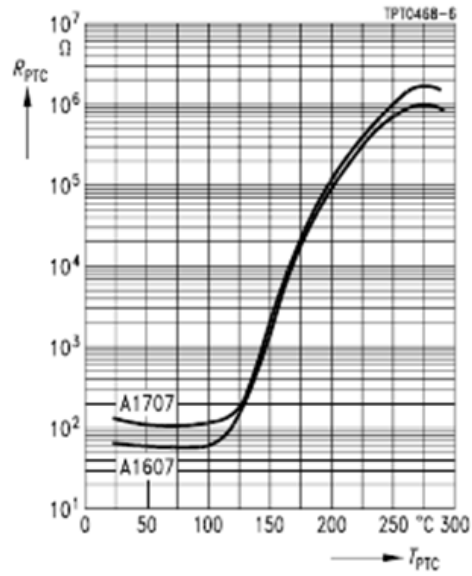
开关周期 (典型值)。	N	100	
参考温度	T _{REF}	120	°X
PTC温度 (V = V _{最大})	T _{PTC}	190	°X
电阻容差	? R _N	± 25 %	
工作温度范围 (V = 0)	T _∞	- 40/+ 125	°X
	(V = V _{最大}) T _∞	0/60	°X

TYPE	I _N ¹⁾ mA	I _ε ¹⁾ mA	I _{GMAX} (V=V _{最大}) A	R _N ?	R _ε ?	t _ε ε	订购代码
V_{最大} = 80 V, V_N = 63 V							
A 1707	45	90	0,3	125	75	< 2,5	B59707-A1120-A62
V_{最大} = 30 V, V_N = 24 V							
A 1607	65	130	0,4	55	30	< 5,0	B59607-A1120-A62

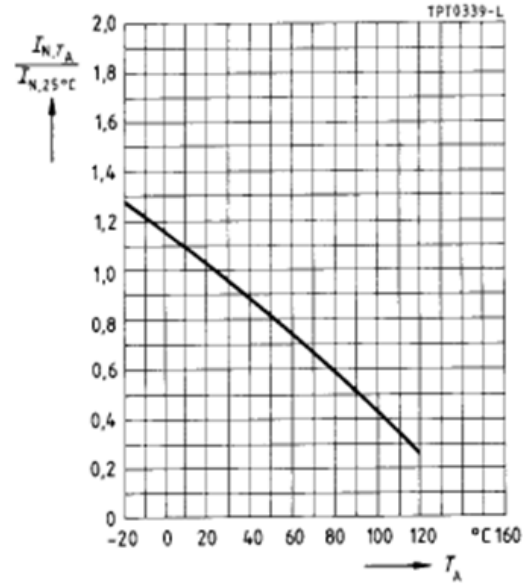
¹⁾ 测得的峰 - 峰

特性（典型值）

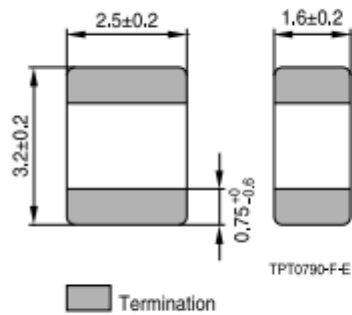
PTC电阻 R_{PTC} 与
PTC温度 T_{PTC}
(在低电压信号测量的)



额定电流 I_N 随环境温度 T_A
(在静止空气中测量)

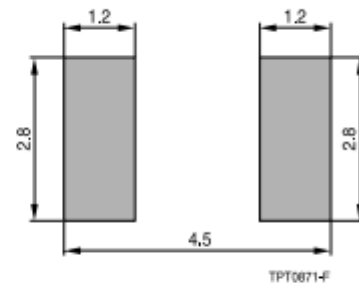


EIA case size 1210



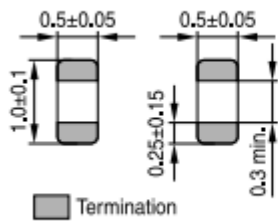
Termination

Solder pad



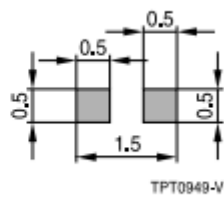
Recommended maximum dimensions (mm)

EIA case size 0402



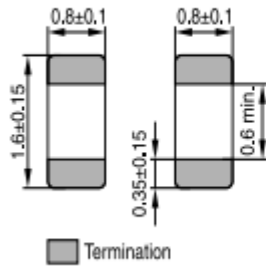
TPT0948-M-E

Solder pad



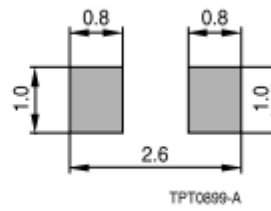
TPT0948-V

EIA case size 0603



TPT0898-5-E

Solder pad



TPT0898-A